



2024 馬來西亞國際工程創新發明展

PiENVEX

我們很榮幸地邀請您參加「2024 馬來西亞 PiENVEX 國際工程創新發明展」，這是一個全球公認的展覽，旨在展示新的研究和創新的解決方案。此次活動將於 4 月 26 日至 28 日在馬來西亞的玻璃市隆重舉行。

PiENVEX 的目標是促進國際間的交流和合作，將世界各地的創意和創新匯聚在一起，推動科學和技術的發展。這不僅是一個展示您最新研究成果和解決方案的機會，還是一個學習和交流的平台，有助於激發您的創造力和潛力。

透過 PiENVEX 展覽中的研討會、創新發表會以及廠商媒合會，為您提供更多商業機會，同時推動科學和技術的進步。這也是一個促進跨學科合作的良機，有助於為未來的科學和技術發展建立重要的平台。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會，誠摯地邀請您參與 PiENVEX，與世界各地的同行共同分享您的研究、交流您的想法，並在這個國際盛會上展現您的創新成果。



世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗



台灣發明商品促進協會 會長 施養隆

敬邀

2024 馬來西亞國際工程創新發明展

PIENVEX

主辦單位：馬來西亞研究與創新協會

展覽日期：2024年4月26日~4月28日

展覽地點：Dewan Ilmu會議展覽中心，馬來西亞玻璃市

參展費用：35,000/件，包含5位發明人報名費、展位費、桌椅及評比費。

選購品項：3,000/件，海報設計及印刷。

託展費用：10,000/件，包含現場布置、解說及作品運送。

早鳥加碼：2024年3月31日前報名，贈送一則電子新聞曝光。(由TIPPA
挑選最佳曝光之電子媒體，視參賽作品之屬性而定。)

【 WIIPA及TIPPA 配合之電子媒體 】

Google新聞、台灣產經新聞網、台灣新聞聯播網、
Yam蕃新聞、NEWSBUFFET、數位之牆、match生活網



報名資訊：台灣發明商品促進協會 (TIPPA)

報名日期：2024年3月31日截止

繳費日期：2024年4月7日截止，逾期取消參賽資格

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網 址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215